

マイクロソルダリング技術 教育・認証フェスタ

～ ソルダリング実装部の品質・信頼性 ～

【 主 催 】

社団法人 日本溶接協会
マイクロソルダリング要員認証委員会、マイクロソルダリング要員評価委員会、マイクロソルダリング教育委員会

【 開催日時および会場 】

平成 23 年 10 月 6 日 (木) 10:30～17:00 於：芝浦工業大学 豊洲キャンパス 交流棟 大講義室

【 開 催 趣 旨 】

電子・電気製品を支える実装技術は様々な分野で目まぐるしく変化する新技術を採用した製品が作られており、厳しい環境での使用や長期運用など、高い製造技術・材料・評価試験方法・検査方法による高い品質、高い信頼性が求められております。

日本溶接協会では、これまでマイクロソルダリング技術の教育および技術資格の認証を行っており、資格取得者を中心に様々な方々に対して、最新のマニュアルソルダリング用機器・材料・評価装置の展示、最新

の技術動向を通じて、マイクロソルダリング実装の展開を知って頂く場として、平成 18 年から「マイクロソルダリング技術 教育・認証フェスタ」を開催しております。今回は「ソルダリング実装部の品質・信頼性」をテーマに、最新情報をご提供させて頂くことと致しました。事業主や製造責任者の方々にも参加頂き、基盤技術としてのマイクロソルダリング技術・実装技術を深くご理解頂ければ幸いです。

【 プ ロ グ ラ ム 】

10:30-10:40	開催の挨拶	マイクロソルダリング要員評価委員会 委員長 竹本 正
10:40-11:00	「マイクロソルダリング技術資格制度の概要」	マイクロソルダリング教育委員会 委員長 藤本 公三
11:00-11:40	「ソルダリング実装工程の管理・メンテナンス」	化研テック(株) 鎌田 信雄
11:40-12:20	展 示 品 紹 介 (5分程度/1件)	
12:20-14:15	昼 食 休 憩 ・ 展 示 見 学	
14:15-14:30	マイクロソルダリング技術賞 表彰式	
14:30-15:00	「次世代パワーデバイス実装技術」	富士電機(株) 高橋 良和
15:00-15:30	「電子デバイス実装部の熱疲労信頼性」	芝浦工業大学 工学部 荻谷 義治・神田 喜彦
15:30-15:50	休 憩 ・ 展 示 見 学	
15:50-16:20	「ソルダ材料と品質・信頼性」	(株)ニホンゲンマ 萩尾 浩一
16:20-16:50	「JEITA 第2世代リフロー用鉛フリーソルダペースト標準化プロジェクトにおけるプロファイル加熱ぬれ性試験」	山陽精工(株) 平本 清
16:50-17:00	閉会の挨拶	マイクロソルダリング教育委員会 委員長 藤本 公三

プログラムの題目・内容は変更になる場合があります。予めご了承願います。
なお、最新詳細情報はホームページ「<http://www.jwes.or.jp/ms/>」を参照願います。

<< お手数ですが、関係各所に回覧願います。 >>

【 参加申込方法 】

本紙下部の申込書(コピー可)に必要事項を記入し、下記申込先にFAXにて平成23年9月30日までにお送り下さい。受付後、折り返し参加票をFAXにて送付致します。シンポジウム当日は、必ず会場受付まで参加票をお持ち下さい。参加票をお持ちでは無い方は、ご入場をお断りする場合がございます。

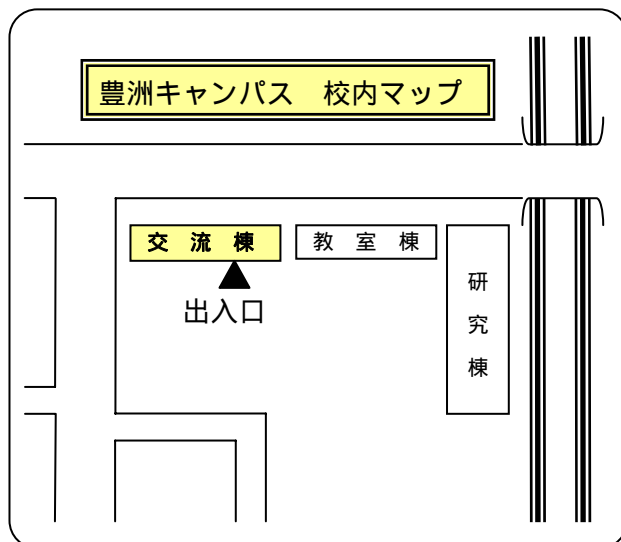
会 場 : 芝浦工業大学 豊洲キャンパス 交流棟 大講義室 (〒135-8548 東京都江東区豊洲3-7-5)

参加定員 : 400名(先着順、定員になり次第締切り)

参加費用 : 無 料

お申込先 : (社)日本溶接協会 担当 : 作道、田川 (TEL : 03-3257-1526 FAX : 03-3255-5196)

【 会場案内図 】



FAX : 03-3255-5196 社団法人 日本溶接協会
マイクロソルダリング技術 教育・認証フェスタ 事務局 宛

<<参加申込書>>

ふりがな		
氏名	(姓)	(名)
ふりがな	ふりがな	
勤務先 (所属先名)	電話番号 ()	FAX ()
同 上 所在地	〒	
E-mail		

複数のお申し込みの場合には、本紙をコピーしてお使い下さい。